

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第7部門第2区分  
【発行日】令和4年7月4日(2022.7.4)

【公開番号】特開2022-70956(P2022-70956A)  
【公開日】令和4年5月13日(2022.5.13)  
【年通号数】公開公報(特許)2022-084  
【出願番号】特願2022-19951(P2022-19951)  
【国際特許分類】

H 0 5 K 1/02(2006.01)

10

H 0 1 L 23/12(2006.01)

H 0 1 L 23/36(2006.01)

H 0 1 L 33/62(2010.01)

H 0 1 S 5/023(2021.01)

【F I】

H 0 5 K 1/02 F

H 0 1 L 23/12 J

H 0 1 L 23/36 C

H 0 1 L 33/62

H 0 5 K 1/02 C

20

H 0 1 S 5/023

【手続補正書】

【提出日】令和4年6月24日(2022.6.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

30

【請求項1】

前記第1面および該第1面と反対側の第2面を有する第1基板と、  
炭素材料からなる第2基板と、  
前記第1基板に位置した2つの第1ビア導体と、を備え、  
該2つの第1ビア導体は、平面視で第1方向に並んで位置し、  
前記第2基板は、平面視で前記第1基板の内側かつ前記2つの第1ビア導体の間に位置し  
ており、  
前記第2基板は、前記第1方向の熱伝導より前記第1方向に垂直に交わる第2方向の熱伝  
導が大きい、電子素子搭載用基板。

【請求項2】

40

前記第1方向の縦断面視において、前記第2基板は、厚み方向に垂直に交わる方向より厚  
み方向の熱伝導が大きい、請求項1に記載の電子素子搭載用基板。

【請求項3】

前記第1基板に位置した複数の第2ビア導体を備え、  
平面視において、1つの第1ビア導体と前記複数の第2ビア導体とは、前記第2方向に並  
んでいる、請求項1または請求項2に記載の電子素子搭載用基板。

【請求項4】

平面視において、前記第2基板が方形状であり、  
平面視において、前記2つの第1ビア導体は、前記第2基板の相対する辺に沿って並んで  
いる、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の電子素子搭載用基板。

50

## 【請求項 5】

平面視において、前記第 2 基板が方形状であり、  
平面視において、前記第 2 基板の相対する辺と、前記 2 つの第 1 ピア導体が前記第 2 基板を挟んで位置した方向とが斜めに交わっている、請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の電子素子搭載用基板。

## 【請求項 6】

平面視において、前記 1 つの第 1 ピア導体および前記複数の第 2 ピア導体からなるピア導体群を複数有し、  
前記複数のピア導体群は前記第 2 方向にそれぞれ並んでいる、請求項 3 に記載の電子素子搭載用基板。

10

## 【請求項 7】

前記第 1 基板の前記第 1 面および前記第 2 面に導体層をそれぞれ有し、  
前記第 1 ピア導体の両端部は前記導体層にそれぞれ接続されている、請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかに記載の電子素子搭載用基板。

## 【請求項 8】

前記第 1 基板の前記第 1 面および前記第 2 面に導体層をそれぞれ有し、  
前記第 1 ピア導体および前記複数の第 2 ピア導体の両端部は前記導体層にそれぞれ接続され、  
前記第 1 ピア導体と前記複数の第 2 ピア導体とは共通の電位に接続されている、請求項 3 に記載の電子素子搭載用基板。

20

## 【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかに記載の電子素子搭載用基板と、  
該電子素子搭載用基板の搭載部に搭載された電子素子とを有している、電子装置。

## 【請求項 10】

前記電子素子搭載用基板が搭載された配線基板または電子素子収納用パッケージを有している、請求項 9 に記載の電子装置。

## 【請求項 11】

請求項 9 または請求項 10 に記載の電子装置と、  
該電子装置が接続されたモジュール用基板とを有する、電子モジュール。

30

40

50